

經濟部 111 年度
臺灣資安卓越深耕-半導體及資通訊供應鏈資安關鍵技術發展
計畫
合作研究計畫

《供應鏈資安個案研究與資訊服務推廣》

建議書徵求文件

財團法人資訊工業策進會

中華民國 111 年 1 月 18 日

111年度合作研究計畫建議書徵求文件

一、簡介

為協助我國半導體供應鏈與國際供應鏈資安規範接軌，透過與半導體相關組織合作研究，共同進行供應鏈資安個案研究與資訊服務推廣，使廠商在開發設計與生產製造階段即將國際資安規範納入考量，以降低廠商資安風險及合規成本。

二、計畫目標

以半導體上、中、下游產業供應鏈為範圍，協助半導體企業進行接軌國際供應鏈之合規暨個案研究分析，並產出分析報告。

三、計畫範圍

1. 半導體企業資安現況線上調查
以半導體上、中、下游產業供應鏈為範圍，協助半導體企業進行接軌國際供應鏈之合規現況線上調查，並產出分析報告。
2. 半導體企業及供應鏈相關之資安合規個案研究
深入訪談半導體企業及供應鏈相關之資訊安全管理制度與防護措施，協助企業進行接軌國際供應鏈之合規暨個案研究分析，並產出分析報告。

四、預期成果(明確說明合作研究成果之產出)

預期成果包含：

1. 半導體企業資安現況線上調查報告：
推薦30家半導體廠商參與資安現況線上調查，其中至少包含15家廠商是上一年度還未參與調查的廠商(由本會提供得標廠商上一年度已參與廠商名單)。分析廠商資安合規優勢與弱勢，產出1份「半導體供應鏈資安個案現況線上調查報告」。
2. 半導體企業及供應鏈相關之資安合規個案研究：
推薦8家半導體企業參與接軌國際供應鏈之個案研究，其中至少包含3家廠商是上一年度還未參與個案研究的廠商(由本會提供得標廠商上一年度已參與廠商名單)。提供該企業之產品、服務、流程與其供應鏈上下游相關資訊，並產出1份「半導體供應鏈資安個案研究分析報告」。

※前述成果如有專利構想或專利申請產出時，需注意專利申請之新穎性(novelty)。因凡經公開發表之研發成果，如擬申請專利，須於公開發表後6個月內完成，前述成果如是以論文方式公開發表，將無法取得大陸與歐盟等國之專利。

五、執行方式(包括計畫時程、計畫分工方式)

111年6月30日：半導體企業資安現況線上調查規劃：

規劃預計參與資安現況線上調查及供應鏈資安個案研究分析之廠商名單，共同研擬線上調查的執行方案及訪談內容。

111年8月15日：半導體企業資安現況線上調查報告：

以本會提供之專家問卷完成調查30家半導體廠商資安現況，其中至少包含15家廠商是上一年度還未參與調查的廠商(由本會提供得標廠商上一年度已參與廠商名單)。

111年9月15日：半導體企業及供應鏈相關之資安合規個案研究：

以本會提供之訪綱完成8家半導體企業接軌國際供應鏈之個案研究，其中至少包含3家廠商是上一年度還未參與個案研究的廠商(由本會提供得標廠商上一年度已參與廠商名單)。

六、計畫期程及預估計畫總經費

計畫執行區間：111年3月1日至111年9月30日

總經費：450,000元

七、驗收標準(含教育訓練)

111年6月30日：半導體企業資安現況線上調查規劃：

規劃預計參與資安現況線上調查及供應鏈資安個案研究分析之廠商名單，共同研擬線上調查的執行方案及訪談內容，並產出1份「半導體供應鏈資安現況線上調查及個案研究執行方案」。

111年8月15日：半導體企業資安現況線上調查報告：

推薦30家半導體廠商參與資安現況線上調查，其中至少包含15家廠商是上一年度還未參與調查的廠商(由本會提供得標廠商上一年度已參與廠商名單)。分析廠商資安合規優勢與弱勢，產出1份「半導體供應鏈資安個案現況線上調查報告」。

111年9月15日：半導體企業及供應鏈相關之資安合規個案研究：

推薦8家半導體企業參與接軌國際供應鏈之個案研究，其中至少包含3家廠商是上一年度還未參與個案研究的廠商(由本會提供得標廠商上一年度已參與廠商名單)。提供該企業之產品、服務、流程與其供應鏈上下游相關資訊，並產出1份「半導體供應鏈資安個案研究分析報告」。

八、技術能力需求(請詳述所需要之技術能力或專長)

1. 熟悉半導體產業國際供應鏈資安趨勢。
2. 具備半導體國際供應鏈之合規與個案研究分析相關經驗